

有意投資於配售股份的投資者於作出有關投資於本公司的任何決定前，應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，尤其是下列關於投資於本公司的風險及特別考慮因素。本公司的業務、財務狀況及經營業績可能會受到任何該等風險或本公司未有察覺的其他風險因素及不明朗因素，或本公司現時認為微不足道的投資因素的重大不利影響。股份的成交價格或會因任何該等風險因素及不明朗因素而下跌，並導致閣下損失全部或部分於股份的投資。

本集團相信，其經營涉及若干風險及不明朗因素，部分並非本集團所能控制。本集團已將此等風險及不明朗因素分類為：(i)與本集團及其業務有關之風險；(ii)與行業有關之風險；及(iii)與股份及配售有關之風險。

與本集團及其業務有關之風險

依賴少數主要客戶

本集團與其客戶維持緊密關係的能力對其持續的增長及盈利能力而言甚為重要。儘管本集團向特定客戶所作的銷售每年不同，但於往績記錄期間，本集團總收益中主要部分乃來自少數主要客戶。截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零一一年六月三十日止六個月，五大客戶分別佔本集團收益約79.2%、87.7%及75.5%，而最大客戶則分別佔本集團收益約28.9%、55.0%及36.6%。

由於本集團並無與其客戶訂立長期或總銷售合約，概無保證任何其主要客戶將如過往繼續向本集團購買相同水平的產品，或購買任何產品。倘本集團任何主要客戶顯著減少向本集團購買的數量或彼等與本集團終止業務關係，本集團之業務及財務表現可能受到不利影響。此外，由於客戶甲（本集團之最大客戶）於截至二零一零年十二月三十一日止年度逾期付款，且持續至截至二零一一年六月三十日止六個月（有關詳情請參閱本招股章程「財務資料」一節），概無保證本集團之主要客戶於本集團授予之信貸期內將向本集團繳款。倘任何本集團之主要客戶延遲向本集團付款，本集團之營業額及現金流量可能遭受重大及／或不利影響。客戶甲其後已於往績記錄期間清還所有未償結餘。

風險因素

由於本集團過往於往績記錄期間及截至二零一一年十月三十一日止四個月的表現顯著波動，難以評估本集團之經營業績及未來前景

於往績記錄期間及截至二零一一年十月三十一日止四個月，本集團過往之表現出現顯著波動，本集團於過往之經營業績未必為本集團未來表現之指標。

截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團之收益較截至二零零九年十二月三十一日止年度上升約160.5%，並於截至二零一零年十二月三十一日止年度達至其歷史高位。此上升之主要原因為ASIC服務下的電子煙集成電路產品的需求顯著上升所致。本集團之年內溢利亦由截至二零零九年十二月三十一日止年度約400,000港元增加至截至二零一零年十二月三十一日止年度約15,900,000港元。

根據本集團的未經審核財務報表，本集團於二零一一年七月至二零一一年十月期間錄得收益約20,400,000港元。截至二零一一年十月三十一日止十個月之總收益約45,600,000港元，較截至二零一零年十月三十一日止十個月減少約13.6%。本集團於截至二零一一年十月三十一日止十個月錄得的除稅後溢利亦較截至二零一零年十月三十一日止十個月為低。

鑑於本集團於往績記錄期間及截至二零一一年十月三十一日止四個月之收益及盈利能力出現波動，本集團無法保證可維持或增加本集團的溢利。本集團能否達致有利可圖將視乎其現有業務及產品的表現以及其業務策略的順利推行。本集團之收益及盈利能力受到多項非本集團所能控制的因素的影響。本集團之經營業績可能受到任何該等因素的不利影響。

依賴分包商

本集團從事設計、開發及銷售集成電路，製造則由其分包商負責。本集團並不直接涉及集成電路開發過程的其他部分，即生產光罩組、製造晶圓、測試晶圓及晶片包封。分包商受聘進行此等非本集團直接控制的步驟。本集團應付五大分包商的購買成本及分包費用分別佔本集團截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一一年六月三十日止六個月應付分包商的總採購成本及分包費用約88.3%、91.3%及82.9%，而最大分包商則分別佔本集團截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一一年六月三十日止六個月應付分包商的總採購成本及分包費用約26.6%、39.7%及23.2%。此等生產步驟如有任何缺失或受到干擾或與此等分包商發生糾紛，可導致本集團無法符合客戶訂單之設計規格、品質標準、數量或運送時間表或其他方面的要求。於此情況下，或會對本集團之業務造成不利影響。

風險因素

本集團不時根據其客戶之訂單，向分包商開出獨立的採購訂單。於二零一一年，本集團與兩間主要分包晶片包封廠訂立分包協議。分包協議之期限由一年至兩年半，各訂約方同意晶片包封廠以固定價格為若干數量的集成電路提供晶片包封服務。除與兩間主要晶片包封廠訂立之分包協議外，本集團一般並無與其分包商訂立任何長期合約。分包商之產能未必足以應付本集團增多的訂單。此外，概無保證本集團現有之分包商將繼續經營或以本集團同意的條款接受本集團之訂單。倘本集團未能保證獲此等分包商提供服務或及時覓得合適的替代者，本集團之業務可能遭受嚴重擾亂及不利影響。

無法預測客戶訂單

本集團按個別訂單出售集成電路產品予其客戶。客戶無須向本集團保證最少購買量。本集團可能僅獲提供非承諾採購預測。由於缺乏固定採購保證，本集團難以預測未來訂單數量及收益，以計劃有效及理想的資源分配及生產。概無保證本集團之客戶將繼續以相若的數量、價格及時間間距向本集團開出訂單。本集團之盈利能力、經營業績及財務狀況可能因此受到影響。此外，由於市場對半導體之需求容易受到整體經濟概況之影響，而各個別集成電路產品之需求則受最終電子產品的市場、競爭的激烈程度以及是否出現替代品及新科技等因素所影響，本集團之經營業績可隨時期而轉變，且可能顯著波動。不同期間的財務表現比較可能變得意義不大，且於某些期間內，本集團之經營業績可能較市場分析及投資者之預期為差。

來自轉介代理之新業務

截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度各年／期間及截至二零一一年六月三十日止六個月，由轉介代理向本集團轉介的業務帶來的總收益分別約為1,600,000港元、36,000,000港元及2,200,000港元，佔本集團於相關期間的總收益約6.4%、54.5%及8.7%。本集團並無訂立任何持續協議委任任何轉介代理以轉介新客戶及／或新項目，而各項由代理轉介之業務將由本集團參照其優點而作出評估。概無保證各個個案均獲受理及轉介代理於未來將繼續轉介新客戶及／或新項目予本集團。倘此等代理終止向本集團轉介新業務，且除非本集團能自行或從其他途徑為本集團引入其他業務以彌補該等收益虧損，否則本集團之收益可能會受到不利影響。

競爭

集成電路產品品牌眾多，市場競爭激烈。一些競爭對手擁有更多財務及技術資源，以減價及給予較長信貸期或其他方法，與本集團進行更激烈的競爭。

風險因素

MiniLogic 品牌集成電路於集成電路市場並非領先品牌，正面對擁有較高市場佔有率及資源更充足的領先品牌的競爭。倘更多集成電路產品於市場出現，競爭將變得更為激烈。

倘本集團無法保持其競爭力，本集團之業務及未來增長可能遭受不利影響。

研究、設計及開發集成電路過程中之不明朗因素

本集團一般根據其本身的研究、設計及開發工作設計及開發其集成電路。一般而言，研究、設計及開發過程由初始規格、線路設計、集成電路佈圖、測試至最後向市場推出最終產品最少須時四個月。然而，過程可因客戶評估、接受及修改工作而延長。根據本集團之過往經驗，整個過程最終可持續25個月。研究、設計及開發過程須投資大量資源及人力。然而，概無保證預期最終產品可生產或及時供應到市場或所設計的最終產品是否有銷路。倘研發失敗或產品未能切合市場需求，將會浪費已投入研究及設計之資源及投資，且本集團之業務將遭受不利影響。

ASIC 服務依賴客戶產品之成功

當進行一項ASIC服務項目時，本集團將根據其客戶對電子產品功能之要求設計及開發集成電路。一些客戶的產品(如電子煙)可能對市場而言為全新產品，且於委託提供ASIC服務之時尚未及時進行市場反應測試。無法確定該透過ASIC服務設計及開發的產品是否存在需求。儘管集成電路設計及開發為因應客戶之要求度身訂造，且部份工程成本由客戶資助，惟倘產品不能成功推出市場，或產品銷量並不可觀，本集團將失去機會將資源分配至更有利可圖的項目。

依賴若干主要管理人員

自本集團開始營業以來，本集團之經營由大致相同的高級管理層領導。有關高級管理團隊之詳細資料載於本招股章程「董事、高級管理人員及僱員」一節。高級管理團隊均具備良好的市場及集成電路產品之開發流程之知識，亦於行內擁有豐富的經驗及廣闊的人脈關係。本集團對彼等非常依賴，倘彼等決定自本集團離職，可能較難覓得代替者。任何高級管理團隊之變動均可影響本集團之未來計劃及前景。

難以聘請擁有工程專門知識及勝任之集成電路設計工程師

集成電路設計工程專門知識乃本集團之主要人力資源。由於本集團之業績取決於創新的設計及產品，本集團吸引及挽留有經驗、熟練、有才幹及擁有工程專門知識之集成電路設計工程師實為必要。市場上擁有工程專門知識且經驗豐富的工程師之供應有限，

風險因素

尤其於香港僅有少量半導體公司，行內對熟練的工程師之競爭更為激烈。倘本集團無法聘請及挽留勝任的集成電路設計工程師，本集團之業務將遭受不利影響。

缺乏現場應用支援服務方面的人力

本集團超過一半的僱員於研發部工作，專注於研究、設計及開發新集成電路產品，並改良現有集成電路產品，以配合本集團作為無晶圓廠之半導體公司之策略。本集團不會就ASIC服務集成電路產品及MiniLogic品牌集成電路產品與集成電路用戶（主要為電子裝置及／或零件之製造商或貿易公司）進行直接交易，客戶可根據彼等之需求要求獲提供現場應用支援服務。由於本集團並無為此等服務設立大型支援團隊，倘該服務需求眾多，本集團可能無法達到客戶之期望。本集團與客戶之關係可能因而惡化，其收益及經營業績可能會遭受不利影響。

知識產權的保護

本集團擁有其設計之集成電路之專利科技及專有技術。倘本集團無法保護此等知識產權，其他競爭對手可根據本集團開發之科技生產及出售產品，導致本集團錄得業務虧損。儘管本集團依賴各項專利註冊、版權保護及附帶不予披露條款之業務協議以保護集成電路產品之知識產權，然而，未經授權方可能複製本集團之產品或科技，且在若干地區無法有效監察此等未經授權使用本集團之知識產權之情況。

涉及知識產權的訴訟及其他糾紛於集成電路行內乃屬常見。本集團未來可能因保護其知識產權或被指控侵害他人之知識產權而捲入訴訟或其他糾紛。由於訴訟及解決糾紛可耗時甚久且費用高昂，本集團之資源可能無法投放於本集團之業務目標，而管理層亦可能無法集中實現該等目標。

若干ASIC產品之部分知識產權之擁有權不屬於本集團

在ASIC分部內，本集團獲客戶委聘為客戶設計及開發特定的集成電路。本集團將利用不同的獨立元件、零件及組件，並設計其中之佈圖及連接（即佈局設計），以符合特定ASIC規格之功能要求。

各種ASIC服務協議有不同條文以規管ASIC產品於不同方面的知識產權。例如在客戶甲的若干份ASIC服務協議下，根據本集團之知識產權律師告知，有條文規定指定產品之產權由各訂約方共同擁有，獨立零件或組件的所有知識產權則屬於本公司，特定佈圖設計的知識產權亦為本公司所有，除前述者外，餘下之產權則由各方平分權益。因此，本集團可能並不擁有部份ASIC產品的所有知識產權。

風險因素

倘若若干ASIC產品之重要知識產權(如該等集成電路之佈圖設計)並不屬於本集團，或客戶可擁有或聲稱擁有若干知識產權，則客戶可委聘其他承包商為彼等生產該ASIC產品，因此，客戶於本集團成功研發該ASIC產品後，可能不會或減少向本集團開出該等ASIC產品之訂單，且本集團未必能賺取收益或甚至須填補研發該ASIC產品之成本。

付款條款影響現金流量

本集團聘用晶圓製造廠生產晶圓。本集團之最大晶圓分包商為一間規模相當大的晶圓製造廠，佔本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度應付分包商之總採購成本及分包費用約39.7%。有別於與本集團訂約之其他晶圓製造廠，此晶圓供應商要求以現金或信用狀預繳以購買晶圓。由於本集團將繼續聘用此晶圓製造廠提供生產服務，該等付款要求將導致本集團須預付巨額現金，可能影響本集團之現金流量及流動資金。

截至二零一一年六月三十日止六個月用於經營活動之現金淨額

截至二零一一年六月三十日止六個月，用於經營活動之現金淨額約為1,500,000港元。用於經營活動之現金淨額主要由於訂金及預付款項顯著增加約7,100,000港元。截至二零一一年六月三十日止六個月之訂金及預付款項顯著上升，主要歸因於預付上市開支約6,800,000港元。儘管本公司預期上市前無需為經營活動支付巨額的額外款項，因此，截至二零一一年十二月三十一日止六個月之經營現金流量預期將較截至二零一一年六月三十日止六個月有所改善，然而，概無保證本集團將於未來產生經營現金流量。根據本集團之未經審核管理賬目，截至二零一一年十月三十一日止十個月，本集團之經營活動產生淨現金約為2,100,000港元。倘本集團無法為其經營產生充足的現金流量，導致本集團無法及時支付其流動負債，本集團之經營可能遭受不利影響。

缺乏產品責任保險

本集團目前並無購買任何產品責任保險。一直以來，本集團並無遭任何第三方提出有關產品缺陷的索償。就董事所知，集成電路供應商購買產品責任保險並非業內慣常做法。由於本集團並無購買任何產品責任保險，倘有任何重大產品責任索償，本集團之業務及財務表現可能遭受不利影響。

上市產生之開支對本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之財務表現造成不利影響

誠如本招股章程「配售原因及所得款項用途」一節內「所得款項用途」分節所闡釋，以配售價每股1.00港元為基準（即配售價範圍之中位數），假設發售量調整權不獲行使，估計上市所產生之開支約為16,200,000港元。此估計開支屬非經常性，來自(i)約7,000,000港元用於發行新股份以作為自權益的扣減；及(ii)約9,200,000港元於上市完成後於本集團之損益賬中扣除。本集團於往績記錄期間並無產生該等與上市有關之開支，而預期本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之財務表現將因此等開支而遭受不利影響。

未能與香港應科院續訂授權協議

香港應科院授予本集團非獨家及不可轉讓授權，以將香港應科院擁有之知識產權（於與香港應科院訂立之相關授權協議內訂明）應用於本集團之最終產品。微創高科自其成立以來已經與香港應科院訂立六份授權協議。根據此等與香港應科院訂立之協議，本集團（其中包括）獲授權於介乎兩年至五年之年期內使用香港應科院擁有的知識產權（於與香港應科院訂立之相關授權協議內訂明），惟須向香港應科院支付前期支付固定授權費及特許權費。截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度各年以及截至二零一一年六月三十日止六個月，結合香港應科院的知識產權製成的集成電路的銷售收益分別約達13,000港元、1,900,000港元及600,000港元，佔本集團於各有關期間的整體收益約0.05%、3.0%及2.5%。概無保證香港應科院將於前述之協議屆滿後，以相同或相若之條款與微創高科續訂授權協議。倘微創高科無法以相同或相若的條款與香港應科院續訂前述授權協議，本集團之業務及財務表現可能遭受不利影響。

本集團業務之季節性

本集團之業務性質一般存在季節性，董事相信主要由於農曆新年期間，中國（本集團之主要市場）的部分廠房停止生產消費電子產品所致。本集團於下半年錄得之銷量一般較上半年為高。然而，對本集團產品之季節性需求可能於未來為本集團之銷量帶來重大影響。由於本集團大部分開支屬於固定成本性質，任何此等季節性銷售下跌均影響本集團之業務及經營業績。

與行業有關之風險

市場對集成電路之需求反覆無常

本集團之集成電路產品用於各種電子產品，如DVD播放器、監察系統及電子煙等。此等最終產品之市場情況可能反覆無常，亦非本集團所能控制。倘此等市場於日後衰退，將可能對本集團之集成電路產品需求及本集團業務造成不利影響。

對日新月異的科技之反應

集成電路行業的特色是科技發展迅速、標準及技術一直演變及經常推出新產品。各集成電路產品的價格一般由於產品陳舊過時及需求下降而於產品壽命週期內下跌。消費者可能轉投更先進的產品，由於更多集成電路供應商可大量提供相似產品，導致競爭加劇。當市場接受該產品之修改且該現有產品並無新應用方法時，價格會加速下跌。因此，本集團之成功視乎其能否持續推出為市場接受之創新產品，以維持或改善其產品之盈利能力。無法及時以及在對生產與付運造成最少干擾的情況下推出新產品，可能會對本集團之業績、經營或財務狀況造成不利影響。倘本集團未能持續設計及開發先進且有銷路之產品，消費者可能轉向本集團之競爭對手購買較多產品，導致本集團產品之平均售價及該等產品之銷量下跌，令本集團之經營收益減少。

無法跟上科技發展的步伐

集成電路設計行業之科技發展急速，且若干集成電路產品之壽命週期變得更短。為於此行業生存及發展，本集團須準確與及時預計市場趨勢之改變及新產品之出現，從而可開發新產品以跟上市場發展的步伐。由於集成電路產品為用作製造其他最終產品之元件，本集團亦需要預測此等產品之未來發展。倘本集團未能跟上集成電路產品及使用該等集成電路產品之最終產品之科技發展，其集成電路產品之需求可能會受到影響，繼而將對本集團之收益構成不利影響。

與股份及配售有關之風險

股份缺乏活躍交投市場及股份成交價格大幅波動之可能性

股份上市前並不存在股份的公開市場。我們已向聯交所申請批准股份上市及買賣。然而，股份於聯交所上市並不保證股份於上市後將有一個流動公開市場。倘股份於上市後未能建立一個活躍公開市場，股份之市場價格及流動性將遭受不利影響。

風險因素

倘本公司日後發行額外的股份則會對股份造成潛在攤薄影響

本公司可能於日後為其營運及業務戰略(包括與收購及其他交易有關者)提供所需的資金、調整負債股權比率、於行使尚未行使之認股權證或購股權時履行責任或其他原因發行權益證券。發行該等權益證券均可攤薄現有股東的權益及令股份的成交價大幅下跌。

倘本公司於日後以低於每股有形資產賬面淨值的價格發行額外股份，則股份投資者可能面對股份的每股有形資產賬面淨值被攤薄。